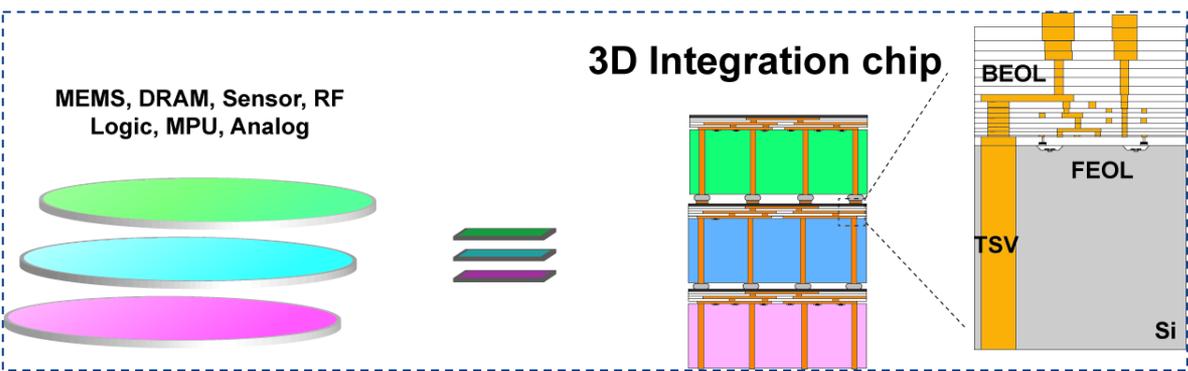
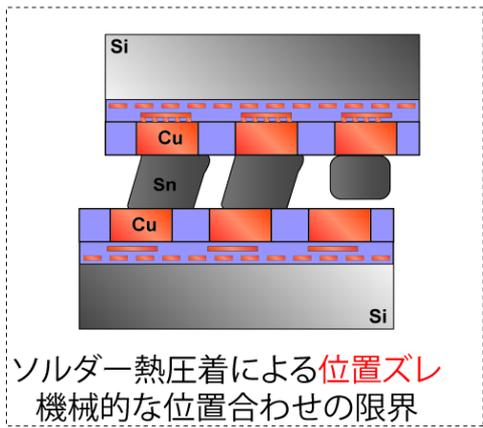


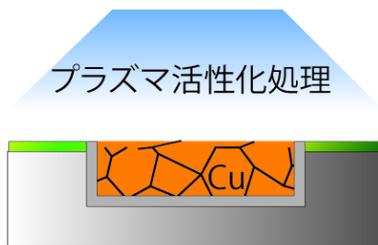
## —原子レベルの平坦性が可能にする直接接合による3Dヘテロデバイスの創成—



現行接合プロセスの問題点

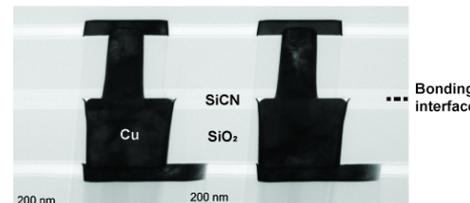
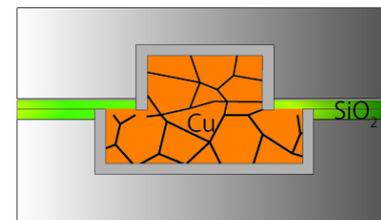


新規接合技術ハイブリッド接合



利点

接着層不要で直接接合  
一括で機械、電気的な接合が可能  
触れるだけで強固な接合。  
高精度位置合わせ可能



次世代三次元実装への応用、実用化を見据えた先端微細加工技術の研究